

熱疲労特性と耐落下衝撃性の両方に優れた弊社独自の低銀はんだ組成により、高い接合信頼性と低コスト化を実現します。

特徴

- 低銀組成でありながら、Sn-3.0Ag-0.5Cuよりも高い接合強度と耐落下衝撃性を実現します。
- Sn-3.0Ag-0.5Cuと同じリフロープロファイルでの使用が可能です。

合金組成

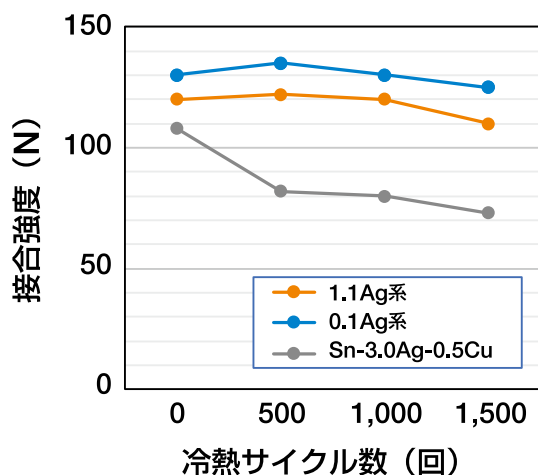
<特許査定済み>

	低銀タイプ	銀レスタイプ	SAC305
組成	Sn-1.1Ag-0.7Cu-1.7Bi + α	Sn-0.1Ag-0.7Cu-2.0Bi + β	Sn-3.0Ag-0.5Cu
融点	223℃	225℃	219℃
強度	64MPa	71MPa	42MPa
伸び	35.2%	26.2%	33.7%

接合信頼性

- 接合強度と耐落下衝撃性の両方に優れる

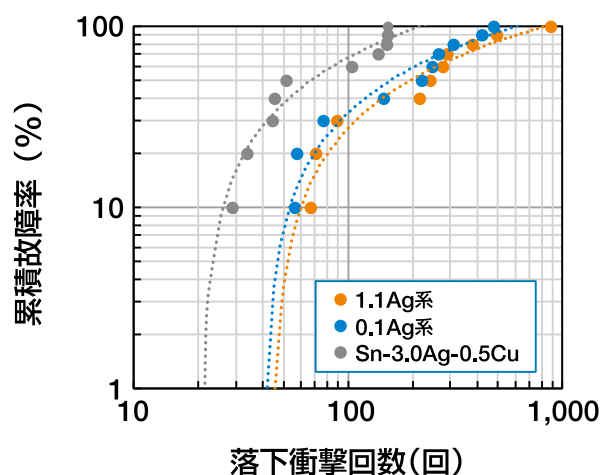
接合強度 (冷熱サイクル試験)



評価条件

- 評価基板: FR4/Cu電極
- マスク厚: 150 μ m
- 評価部品: 3216抵抗
- 冷熱サイクル: -40℃ \leftrightarrow 125℃ (各30分)

耐落下衝撃性



評価条件

- 評価基板: FR4/Cu電極
- マスク厚: 120 μ m
- 評価部品: 0.5mmピッチLGA
- 落下衝撃条件: JEDEC 1,500G準拠